

## 盛美半导体设备（上海）股份有限公司

### 关于2025年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 重要内容提示：

- 每股分配比例：每10股派发现金红利6.233元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户持有公司股份后的股本总额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
- 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板股票上市规则》）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

#### 一、利润分配方案的内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（信会师报字[2026]第ZI10018号），2025年母公司实现税后净利润1,167,854,942.28元，提取法定盈余公积金20,712,018.00元，加上年初母公司未分配利润2,481,323,046.96元，减去2024年度现金分红288,252,734.66元。截至2025年12月31日，母公司实现可供分配利润额为人民币3,340,213,236.58元。经第三届董事会第三次会议决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户持有公司股份后的股本总额为基数进行利润分配。本次利润分配方案如下：

截至2025年12月31日，公司总股本为480,164,789股，以剔除已回购股份443,400股后的总股本为基准，拟每10股派发现金红利6.233元（含税），共计派发现金红利299,010,341.76元（含税），本次利润分配现金分红金额占2025年合

并报表归属于母公司股东净利润的21.42%。本次利润分配不送红股，不进行资本公积转增股本。本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额50,012,340.46元，现金分红和回购金额合计349,022,682.22元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例25.00%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称“回购并注销”）金额0元，现金分红和回购并注销金额合计299,010,341.76元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例21.42%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生增减变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

## 二、是否可能触及其他风险警示情形

公司不存在可能触及其他风险警示情形的情形。

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	299,010,341.76	288,252,734.66	273,189,145.72
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,395,929,467.13	1,153,188,090.00	910,521,979.19
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	3,340,213,236.58		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）(A)	860,452,222.14		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）(B)	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）(C)	1,153,213,178.77		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)(D)	860,452,222.14		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于3,000万元	否		
现金分红比例（%）(E=D/C)	74.61		
现金分红比例（E）是否低于30%	否		
最近三个会计年度累计研发投入金额（元）(F)	2,751,547,232.45		

最近三个会计年度累计研发投入金额是否在3亿元以上	是
最近三个会计年度累计营业收入（元）（G）	16,292,253,365.47
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（%）（H=F/G）	16.89
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（H）是否在15%以上	是
是否触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否

### 三、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润139,592.95万元，拟分配的现金红利总额（包括以现金为对价，采用集中竞价方式当年已实施的股份回购金额）为34,902.27万元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为25.00%，本年度现金分红比例低于30%，具体原因分项说明如下：

#### （一）公司所处行业情况及特点

公司作为一家面向国际科技前沿、坚持自主创新的半导体专用设备企业，遵循全球行业惯例，主要从事技术和工艺研发、产品设计和制造，为客户提供设备和工艺解决方案。半导体设备的研制涉及众多专业学科，具有较高的技术壁垒及较长的验证周期，属于资本密集型和技术密集型产业。公司为了保持产品竞争力，需持续投入大量资金进行研发，持续优化产品或推出新产品，以满足市场需求。因此，公司仍需要投入大量资金以推动研发创新和产品迭代升级。

#### （二）公司所处的发展阶段及自身经营模式

公司始终致力于为全球集成电路行业提供领先的设备及工艺解决方案，坚持差异化国际竞争和原始创新的发展战略。通过持续的自主研发，进一步完善了知识产权体系，凭借丰富的技术和工艺积累，形成了平台化的半导体工艺设备布局，包括清洗设备、半导体电镀设备、立式炉管系列设备、前道涂胶显影Track设备、等离子体增强化学气相沉积PECVD设备、无应力抛光设备；后道晶圆级先进封装工艺设备、面板级先进封装设备；以及硅材料衬底制造工艺设备等。报告期内，公司主营业务收入来源于半导体设备的销售，营收规模逐年扩大，处于快速发展的阶段。公司坚持“技术差异化、产品平台化、客户全球化”发展战略，持续投

入大量资金用于技术创新和产品研发，进一步提升公司收入和利润规模，维护好公司价值，为股东和投资者创造更多回报。

### （三）公司盈利水平及资金需求

2025年，公司实现归属于上市公司股东的净利润为139,592.95万元，同比增长21.05%。2026年，公司将继续加大研发投入和技术创新，在实现对原有产品的迭代优化和性能提升的同时，加速对新产品的研发及市场布局。因此，公司须预留足额资金来满足研发投入、业务发展及流动资金需求，充分保障公司的平稳运营、健康发展。

### （四）公司现金分红水平较低的原因

综合考虑公司所处行业发展情况、公司发展阶段及自身经营模式、盈利水平及资金需求，制定了公司2025年度利润分配预案，以保障公司的可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益。

### （五）公司留存未分配利润的预计用途以及收益情况

公司2025年度留存未分配利润将累计滚存至下一年度，以满足公司生产经营、研发创新等需求。公司将继续严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展的成果。

（六）公司是否按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利

公司已按照中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利。公司建立及健全了多渠道的投资者交流机制，中小股东可以通过电话、邮箱、上证e互动、业绩说明会、投资者交流会等多种形式来表达对现金分红政策的意见和建议。同时，公司股东会以现场会议形式召开并提供现场投票和网络投票，为股东参与股东会决策提供便利。

### （七）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

公司在《公司章程》中制定了利润分配政策，并连续三年披露“提质增效重回报”行动方案。公司将继续秉承为投资者带来长期持续回报的理念，从有利于公司长远发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展的成果，为投资者创造更大的价值。

#### 四、公司履行的决策程序

2026年2月26日，公司召开第三届董事会第三次会议，全票审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，并同意提交公司2025年年度股东会审议，经批准后实施。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

#### 五、相关风险提示

公司本次利润分配预案结合了公司目前的发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

公司2025年度利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

盛美半导体设备（上海）股份有限公司

董事会

2026年2月27日